

Rockchip RK3399 软件开发指南

发布版本:1.00

日期:2016.08

前言

概述

文档主要介绍 Rockchip RK3399 软件开发指南,旨在帮助软件开发工程师更快上手 RK3399 的开发及调试

产品版本

芯片名称	内核版本	Android 版本
RK3399	Linux4.4	Android6.0.1

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016-08-09	V1.00	YHX,HZB	构建初始版本 缺漏第 6、7 章节
	_	_	

目录

前言			I
目录			. II
1	支持列	表	1-1
	1.1	DDR 支持列表	1-1
	1.2	EMMC 支持列表	1-1
	1.3	WiFi/BT 支持列表	1-2
	1.4	SDK 软件包适用硬件列表	1-2
	1.5	多媒体编解码支持列表	1-3
2	文档/_	工具索引	2-1
	2.1	文档索引	2-1
	2.2	工具索引	2-2
3		扁译/烧写	
	3.1	SDK 获取	3-1
	3.2	SDK 编译	3-1
	3.3	固件烧写	3-3
	3.4	量产烧写	3-4
4		ot 开发	
	4.1	Rockchip U-Boot 简介	4-1
	4.2	平台配置	
	4.3	固件生成	
	4.4	U-Boot 编译	4-2
	4.5	U-Boot 开启关机充电功能	
		WiFi&BT 的配置	
	4.7	U-Boot logo 相关的配置	4-4
	4.8	ARM、GPU 频率修改	
5		iid 常见配置	
	5.1	Android 产品配置	
	5.2	常用功能配置说明	
	5.3	Parameter 说明	
		新增分区配置	
		OTA 升级	
6		具说明	
		StressTest	
		DeviceTest	
		PCBA 测试工具	
	6.4	DDR 测试工具	
	6.5	update.img 打包	
	6.6	固件签名	
		序列号/Mac/厂商信息烧写	
	6.8	量产工具使用	6-1

插图目录

图 1-1 EMMC Performance 示例	1-2
图 1-2 RK3399 目前大量测试的 Wifi/Bt 支持列表	1-2
图 3-1Android 开发工具烧写界面	3-3

表格目录

表 1-1 RK3399	DRAM Support Type	. 1-1
	DDR Support Symbol	
表 1-3 RK3399	EMMC Support Symbol	. 1-1
表 1-4 RK3399	硬件说明列表错误!未定义书	签。

1 支持列表

1.1 DDR 支持列表

RK3399 DDR 目前选型列表支持双通道 DDR3、DDR3L、LPDDR3。

表 1-1 RK3399 DRAM Support Type

Chip	DRAM Support Type					
RK3399	DDR3/DDR3L/LPDDR3					

RK3399 DDR 颗粒支持程度列表,详见 RKDocs\Platform support lists 目录下《RK DDR Support List Ver2.18》,下表中所标示的 DDR 支持程度表,只建议选用 √、T/A 标示的颗粒。

表 1-2 RK3399 DDR Support Symbol

Symbol	Description
√	Fully Tested and Mass production
T/A	Fully Tested and Applicable
N/A	Not Applicable

1.2 EMMC 支持列表

RK3399 支持 eMMC 5.1, SDIO3.0, 可运行 HS200, HS400 模式, 详见 RKDocs\Platform support lists 目录下《RKeMMCSupportList Ver1.29_2016_08_05》,下表中所标示的 DDR 支持程度表,只建议选用 √、T/A 标示的颗粒。

表 1-3 RK3399 EMMC Support Symbol

Symbol	Description
√	Fully Tested , Applicable and Mass Production
T/A	Fully Tested , Applicable and Ready for Mass Production
D/A	Datasheet Applicable, Need Sample to Test
N/A	Not Applicable

1.2.1 高性能 EMMC 颗粒的选取

为了提高系统性能,选取高性能的 EMMC 颗粒也是需要的。请在挑选 EMMC 颗粒前,参照我们的支持列表的型号,对应的研究下厂商提供的 Datasheet,重点关注下厂商标注的 performance 一章节。

参照厂商大小、读写的速率进行筛选。建议选取顺序读速率>200Mb/s、顺序写速率>40Mb/s。如有选型上的疑问,也可直接联系我们的 Fae 窗口。

6.1.5 Performance

[Table 23] Performance

Density	Partition Type	Performance				
	Faithfull Type	Read(MB/s)	Write (MB/s)			
16GB		285	40			
32GB	General	310	70			
64GB	General	310	140			
128GB		310	140			
16GB		295	80			
32GB	Enhanced	320	150			
64GB	Lillianced	320	245			
128GB		320	245			

图 1-1 EMMC Performance 示例

1.3 WiFi/BT 支持列表

RK3399 内核运行 Linux4.4,WiFi/BT 支持列表,详见 RKDocs\Platform support lists 目录下《RK3399_WiFi_Situation_20160808》,下表中所标示为目前 RK3399 上大量测试过的 Wifi/Bt 芯片列表,建议按照列表上的型号进行选型。如果有其他 WiFi/BT 芯片调试,可先与 WiFi/BT 芯片原厂沟通,是否有可以稳定在 Linux4.4 运行的驱动程序,并能提供调试帮助。

另外后续我们会不断更新支持列表,如果疑问和建议可以与我们的 Fae 窗口联系。

		RK3399	Wi-	-Fi	S	tu	ati	on			
WiFi Chip	IFACE	IEEE 802.11 Standard	2.4GHz Band	5.0GHz Band	вт	GPS	NFC	SoftA P	P2P@	4.4 kernel	
AP6354	SDIO	IEEE 802.11A/B/G/N/AC	~	~	✓	×	×	✓	✓	✓	
Realtek RTL8188EUS	USB	IEEE 802.11B/G/N	~	×	×	×	×	✓	✓	✓	
①. 支持P2F	①. 支持P2P功能,支持WiFi Display。										
②. √: 表示驱动支持kernel 4.4,后续验证更多模块后会更新WIFI在kernel 4.4支持列表											

图 1-2 RK3399 目前大量测试的 Wifi/Bt 支持列表

1.4 SDK 软件包适用硬件列表

本 SDK 是基于谷歌 Android6.0 64bit 系统,适配瑞芯微 RK3399 芯片的软件包,适用于 VR 一体机产品形态、VR 分体机产品形态、Tablet 产品形态、sapphire(蓝宝石)& excavator(挖掘机)开发板、及其他基于 RK3399 平台开发的产品。

使用的是 sapphire(蓝宝石) & excavator(挖掘机)开发板的,kernel 配置可直接使用rk3399-excavator-sapphine-box.dts 进行配置。

参考《RK3399_VR&Tablet_V10_20160620》硬件设计的 VR/TABLET 样机,kernel 配置可以参考:

VR:rk3399-vr-android.dts

TABLET:rk3399-mid-818-android.dts

另外随 SDK 发布,附带了 Box 样机板,sapphire(蓝宝石) & excavator(挖掘机)开发板的硬件使用说明。

1.5 多媒体编解码支持列表

RK3399 多媒体方面支持强大,支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达 60fps,1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8),1080P 视频编码,支持 H.264, VP8 格式,视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。

具体的编解码支持列表,详见 RKDocs\Platform support lists 目录下《RK3399 Multimedia Codec Benchmark v1.0》

2 文档/工具索引

2.1 文档索引

RK3399 SDK 发布文档旨在帮助开发者快速上手开发及调试,另由于 RK3399 内核运行版本为 Linux4.4,有些新的知识请大家也多自己补充,文档中涉及的并不能涵盖所有的知识和问题。文档列表也正在不断更新,如有文档上的疑问及需求,请联系我们的 Fae 窗口。

RK3399 SDK 中在 RKDocs 目录下附带了 Develop reference documents(开发指导文档)、Platform support lists (支持列表)、RKTools manuals (工具使用文档)。

RKDocs/
Develop reference documents
RK USB Compliance Test Note V1.2.pdf
│ ├── Rockchip Audio 开发指南 V1.0-20160606.pdf
│ ├── Rockchip DEVFreq 开发指南 V1.0-20160701.pdf
├── Rockchip I2C 开发指南 V1.0-20160629.pdf
│ ├── Rockchip IO-Domain 开发指南 V1.0-20160630.pdf
│ ├── Rockchip Pin-Ctrl 开发指南 V1.0-20160725.pdf
│ ├── Rockchip RK818 电量计 开发指南 V1.0-20160725.pdf
│ ├── Rockchip SDMMC SDIO eMMC 开发指南 V1.0-20160630.pdf
│ ├── Rockchip SPI 开发指南 V1.0-20160629.pdf
│ ├── Rockchip Thermal 开发指南 V1.0-20160701.pdf
│ ├── Rockchip UART 开发指南 V1.0-20160629.pdf
│ ├── Rockchip U-Boot 开发指南 V3.7-20160708.pdf
│ ├── Rockchip USB 开发指南 V1.0-20160704.pdf
│ ├── Rockchip 以太网 开发指南 V2.3.1-20160708.pdf
│ ├── Rockchip 休眠唤醒 开发指南 V0.1-20160729.pdf
│ ├── Rockchip 时钟子模块 开发指南 V1.0-20160630.pdf
│ ├── Rockchip 背光控制 开发指南 V0.1-20160729.pdf
│
Platform support lists
RK3399 Multimedia Codec Benchmark v1.0.pdf
RK3399_WiFi_Situation_20160808.pdf
│
│
RK DDR Support List Ver2.18.pdf
RKeMMCSupportList Ver 1.29_2016_08_05.pdf
RKTools manuals
├── Android 增加一个分区配置指南 V1.00.pdf
├── Android 开发工具手册.pdf
├── Recovery 升级相关文档.rar
├── RK SDK OTA 包生成方法.pdf
├── RK 固件升级失败原因分析_V1.1 20121122.pdf
├── RK 平台 apache_tomcat_ota 服务器搭建说明.rar
├── rk 平台量产升级指导文档 V1.1.pdf

├── Rockchip Parameter File Format Ver1.3.pdf
├── Rockchip PCBA 模块 开发指南--20160808.pdf
├── 压力测试 Stresstest 文档_ver1.1.pdf
└── 量产工具升级及相关问题处理.pdf

2.2 工具索引

RK3399 SDK 发布工具,用于开发调试阶段及量产阶段使用。工具可能随 SDK 更新不断更新,如有工具上的疑问及需求,请联系我们的 Fae 窗口。

RK3399 SDK 中在 RKTools 目录下附带了 linux(Linux 操作系统环境下使用工具)、windows (Windows 操作系统环境下使用工具)。



3 SDK 编译/烧写

3.1 SDK 获取

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布。客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK,需同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权,获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH 公钥授权,请参考《RK3399_ANDROID6.0-BOX-SDK_V1.00_20160809 发布说明.pdf》。

3.1.1 SDK 下载链接

RK3399 ANDROID6.0 SDK 下载地址如下:

repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u ssh://git@www.rockchip.com.cn/gerrit/rk/platform/manifest -b android-6.0 -m rk3399 box marshmallow release.xml

3.1.2 repo

repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本,主要是用来下载、管理 Android 项目的软件仓库,其下载地址如下:

git clone ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo

3.1.3 SDK 代码压缩包

为方便客户快速获取 SDK 源码,瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包。以 rk3399_android6.0_box_v1.00_20160809.tgz 为例,拷贝到该初始化包后,通过如下命令可检出源码:

mkdir rk3399

tar xvf rk3399_android6.0_v1.00_20160809.tgz -C rk3399

cd rk3399

- .repo/repo/repo sync -l
- .repo/repo/repo sync

3.2 SDK 编译

3.2.1 JDK 安装

Android6.0 系统编译依赖于 JAVA 7。编译之前需安装 OpenJDK。

安装命令如下。

sudo apt-get install openjdk-7-jdk

配置 JAVA 环境变量,例如,安装路径为/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64,可在终端执行如下命令配置环境变量。

export JAVA HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64

export PATH=\$JAVA HOME/bin:\$PATH

export CLASSPATH=::\$JAVA_HOME/lib:\$JAVA_HOME/lib/tools.jar

3.2.2 编译模式

SDK 默认以 userdebug 模式编译。

使用 adb 时,需要先执行 adb root 使 shell 获取 root 权限,进而执行其他像 adb remount 等操作。

3.2.3 VR 一体机编译

```
uboot 编译:
```

cd u-boot

make rk3399_defconfig

make ARCHV=aarch64

kernel 编译:

cd kernel

make ARCH=arm64 rockchip_defconfig -j8

make ARCH=arm64 rk3399-vr-android.img -j12

android 编译:

source build/envsetup.sh

lunch rk3399_64_vr-userdebug

make -j12

./mkimages.sh

3.2.4 VR 分体机编译

uboot 编译:

cd u-boot

make rk3399_defconfig

make ARCHV=aarch64

kernel 编译:

android 编译:

source build/envsetup.sh

lunch rk3399_64_vr-userdebug

make -j12

./mkimages.sh

3.2.5 Tablet 编译

uboot 编译:

cd u-boot

make rk3399_defconfig

make ARCHV=aarch64

kernel 编译:

cd kernel

make ARCH=arm64 rockchip_defconfig -j8

make ARCH=arm64 rk3399-mid-818-android.img -j12

android 编译:

source build/envsetup.sh

lunch rk3399_mid-userdebug

make -j12

./mkimages.sh

3.2.6 固件生成步骤

执行./mkimage.sh 后,在 rockdev/Image-xxx/目录生成完整的固件包(xxx 是具体 lunch 的产品名)



3.3 固件烧写

刷机说明详见 RKDocs\ RKTools manuals 目录下《Android 开发工具手册.pdf》。

SDK 提供烧写工具,如下图所示。编译生成相应的固件后,进入烧写模式,即可进行刷机。对于已烧过其它固件的机器,可以选择重新烧录固件,或是选择低格设备,擦除 idb,然后进行刷机。

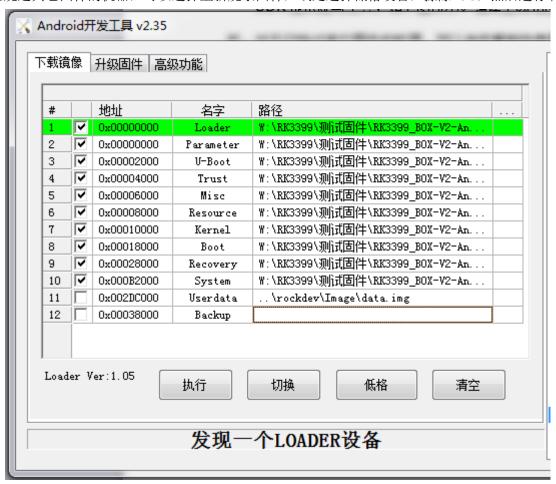


图 3-1Android 开发工具烧写界面

注:烧写前,需安装最新的的USB驱动,驱动详见

RKTools/windows/

├── DriverAssitant_v4.5

3.4 量产烧写

量产上考虑到生产效率及工厂工位安排,量产烧写说明详见 RKDocs\Develop reference document 目录下《Rockchip 量产烧录 指南 V1.0-20160718》。

在量产过程中如涉及到工具上的问题,可以联系我们的 Fae 窗口。

4 U-Boot 开发

本节简单介绍 U-Boot 基本概念和编译的注意事项,帮助客户了解 RK 平台 U-Boot 框架,具体 U-Boot 开发细节可参考 RKDocs\Develop reference documents 目录下《Rockchip USB 开发指南 V1.0-20160704.pdf》。

4.1 Rockchip U-Boot 简介

Rockchip U-Boot 是基于开源的 UBoot 2014.10 正式版进行开发的,主要支持:

- 支持芯片: rk3288、rk3036、rk312x、rk3368、rk322x、rk3366、rk3399等;
- 支持 Android 平台的固件启动;
- 支持 ROCKUSB 和 Google Fastboot 两种方式烧写;
- 支持 secure boot 固件签名加密保护机制;
- 支持 LVDS、EDP、MIPI、HDMI、CVBS 等显示设备;
- 支持 SDCard、Emmc、Nand Flash、U 盘等存储设备;
- 支持开机 logo 显示、充电动画显示,低电管理、电源管理;
- 支持 I2C、SPI、PMIC、CHARGE、GUAGE、USB、GPIO、PWM、DMA、GMAC、EMMC、NAND中断等驱动;

4.2 平台配置

平台配置文件位于 U-Boot 根目录下的 configs 文件夹下,其中 Rockchip 相关的以 RK 开头,并根据产品形态分为 MID 和 BOX 两种配置:

```
rk3288_defconfig
rk3126_defconfig
rk3128_defconfig
rk3368_defconfig
rk3399_defconfig

rk3288_box_defconfig
rk3128_box_defconfig
rk3128_box_defconfig
rk3036_box_defconfig
rk3368_box_defconfig
rk3368_box_defconfig
rk322x_box_defconfig
rk3399_box_defconfig
```

RK3399 VR/Tablet 选用的是 rk3399_defconfig 配置。

4.3 固件生成

Rockchip 平台 Loader 分为一级模式和二级模式,根据不同的平台配置生成相应的 Loader 固件。通过宏 CONFIG_SECOND_LEVEL_BOOTLOADER 的定义二级 Loader 模式。

4.3.1 一级 Loader 模式

U-BOOT 作为一级 Loader 模式,那么仅支持 EMMC 存储设备,编译完成后生成的镜像: RK3399MiniLoaderAll_V1.05.bin

其中 V1.05 是发布的版本号。

4.3.2 二级 Loader 模式

U-Boot 作为二级 Loader 模式,那么固件支持所有的存储设备,该模式下,需要 MiniLoader 支持,通过宏 CONFIG_MERGER_MINILOADER 进行配置生成。同时引入 Arm Trusted Firmware 后会生成 trust image,这个通过宏 CONFIG_MERGER_TRUSTIMAGE 进行配置生成。

以 rk322x 编译生成的镜像为例:

RK322XMiniLoaderAll V2.31.bin

UBOOT.img

trust.img

其中 V2.31 是发布的版本号,rockchip 定义 U-Boot loader 的版本,其中 2.31 是根据存储 版本定义的,客户务必不要修改这个版本。

UBOOT.img 是 U-Boot 作为二级 loader 的打包。

trust.img 是 U-Boot 作为二级 loader 的打包。

RK3036、RK3126、RK3128、RK322x、RK3368、RK3366、RK3399 等采用二级 loader 模式。

4.4 U-Boot 编译

RK3399 SDK 编译使用的是如下配置:

make rk3399 _defconfig

make ARCHV=aarch64

编译完,会生成 trust.img、RK3399MiniLoaderAll_V1.05.bin、uboot.img 三个文件。目前编译出来的 RK3399MiniLoaderAll_V1.05.bin DDR 为定频 666Mhz 版本,为了调试方便,发布 SDK 的同时,我们也在烧写工具目录下提供了不同频率版本的 Loader。

路径: RKTools\windows\AndroidTool\rockdev

DDR 运行 200Mhz: RK3399MiniLoaderAll_V1.05_DDR200MHz.bin DDR 运行 400Mhz: RK3399MiniLoaderAll_V1.05_DDR400MHz.bin DDR 运行 666Mhz: RK3399MiniLoaderAll_V1.05_DDR666MHz.bin DDR 运行 800Mhz: RK3399MiniLoaderAll_V1.05_DDR800MHz.bin

4.5 U-Boot 开启关机充电功能

为了实现充电动画,需要在 uboot/include/configs/rk33plat.h 中打开如下开关,默认该功能是关闭的。

#define CONFIG_UBOOT_CHARGE

#define CONFIG_SCREEN_ON_VOL_THRESD 3400//3.4v

#define CONFIG_SYSTEM_ON_VOL_THRESD 3500//3.5v

其中 CONFIG_SCREEN_ON_VOL_THRESD 是系统点亮屏幕的电压门限,低于这个电压,禁止系统亮屏。 CONFIG_SYSTEM_ON_VOL_THRESD 是系统正常启动的电压门限,低于这个电压,禁止 uboot 启动内核。这两个电压可以根据具体的产品设计灵活调整。

产品板级 dts 中如下节点进行充电模式开关配置,可以灵活配置使用 uboot 还是 Android 的关机充电模式:

uboot-charge {

};

```
compatible = "rockchip,uboot-charge";
rockchip,uboot-charge-on = <0>;
rockchip,android-charge-on = <1>;
```

rockchip,uboot-charge-on 开关 uboot 阶段的充电动画,rockchip,android-charge-on 开关 android 充电动画。内核常见配置

本节简单介绍内核一些常见配置的修改,主要是 dts 的配置,帮助客户更快更方便的进行一些简单的修改。

4.6 WiFi&BT 的配置

4.6.1 WiFi 配置

```
wireless-wlan {
    compatible = "wlan-platdata";
    rockchip,grf = <&grf>;
    wifi_chip_type = "ap6354";
    sdio_vref = <1800>;
    WIFI,host_wake_irq = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* GPIO0_a3 */
    status = "okay";
};
```

上面部分内容是 WiFi 的 dts 配置内容,主要包括电源控制、中断等功能脚的配置。下面将对各个配置项(一般客户只需要修改下面红色标出部分参数)的功能进行详细描述:

```
wifi_chip_type = " ap6354";
```

用来确认 WiFi 芯片型号,实际使用什么型号的 WiFi 需要在这里指定

```
sdio_vref = <1800>; //1800mv or 3300mv
```

这个配置项配置 WiFi 模组的 IO 参考电压值,根据实际硬件设计中提供给 WiFi 模组参考电压输入的电压值来进行设定,参考电压设置错误会导致 WiFi 通信异常引起 WiFi 打不开或者工作不稳定。

WIFI,host_wake_irg = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

这个配置项是 WiFi 中断脚的配置,某些 WiFi 模组没有这个脚可以不用配置直接将此配置项注释掉。使用 Broadcom 的 WiFi 比如 AP6xxx 以及 RK90x 等模组都需要正确配置这GPIO。

Broadcom wifi AP6xxx 系统会使用此中断脚作为 WiFi 数据中断脚,此中断脚有异常将会导致 WiFi 无法正常工作。其它 WiFi,例如 RTL8723BS,在机器进入休眠时,如果有 WiFi 数据到来时此中断用来唤醒机器。此中断脚有异常并不会造成 WiFi 无法正常工作。

4.6.2 BT 配置

```
wireless-bluetooth {
    compatible = "bluetooth-platdata";
    //wifi-bt-power-toggle;
    uart_rts_gpios = <&gpio2 19 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* GPIO2_C3 */
    pinctrl-names = "default", "rts_gpio";
    pinctrl-0 = <&uart0_rts>;
    pinctrl-1 = <&uart0_gpios>;
    //BT,power_gpio = <&gpio3 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* GPIOx_xx */
```

};

```
BT,reset_gpio = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* GPIO0_B1 */
BT,wake_gpio = <&gpio2 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* GPIO2_D2 */
BT,wake_host_irq = <&gpio0 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* GPIO0_A4 */
status = "okay";
```

以上是 BT 在 dts 里面的配置,下面对常见可能需要修改的部分进行简单的说明

BT,reset_gpio = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

这个配置项是关于 BT 的 RESET 脚配置,这个脚不同的 BT 模组不一定都有,具体以实际原理图为准。

BT,power_gpio = <&gpio3 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>

这个配置项是关于 BT 的电源控制 GPIO 配置,高电平有效,具体以实际原理图为准。

BT,wake_gpio = <&gpio2 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

这个配置项是关于 BT 的 WAKE 脚配置, 对应原理图中的 BT WAKE 管脚, 高电平有效。

BT, wake host irg = <&gpio0 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>

这个配置项是关于 BT 的中断脚配置,对应原理图中的 BT_HOST_WAKE 管脚,高电平有效。

```
默认 BT 使用 uart0 接口连接,uart0 的配置如下
&uart0 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&uart0_xfer &uart0_cts>;
    status = "okay";
};
```

4.6.3 GPIO 对应关系注意

关于原理图上的 gpio 跟 dts 里面的 gpio 的对应关系,例如 GPIO4c0,那么对应的 dts 里面应该是"gpio4 16"。因为 GPIOA 有 8 个 pin,GPIOB 也有 8 个 pin,以此计算可得 c0 口就是 16,c1 口就是 17,以此类推;

4.7U-Boot logo 相关的配置

4.7.1 U-Boot logo 开关配置

```
Sdk 默认开启 U-Boot logo 功能,以达到更快显示开机 logo 的目的 rockchip,uboot-logo-on = <1>; 如果需要关闭这个功能的,设置 rockchip,uboot-logo-on = <0>;即可
```

4.7.2 U-Boot logo 图片更换

U-boot logo 显示的两张图片是 kernel 根目录下的 logo.bmp 和 logo_kernel.bmp,如果需要更换,用同名的 bmp 替换掉,重新编译 resource.img 即可。

Ps: 不一定要两张图片,可以只要一张,如果只有一张就保留 logo.bmp 这一张

4.8 ARM、GPU 频率修改

参考 RKDocs\Develop reference documents 目录下《Rockchip DEVFreq 开发指南 V1.0-20160701.pdf》

5 Android 常见配置

5.1 Android 产品配置

5.1.1 lunch 选项说明

```
rk3399_box-userdebug:
                                //rk3399 平台 box 产品 userdebug(64 位)
rk3399_box-user:
                                //rk3399 平台 box 产品 user (64 位)
                                //rk3399 平台 EVB 开发板 userdebug (64 位)
rk3399 64-userdebug:
rk3399_64-user:
                                //rk3399 平台 EVB 开发板 user (64 位)
                               //rk3399 平台 VR 产品 userdebug (64 位)
rk3399 64 vr-userdebug:
                               //rk3399 平台 VR 产品 user (64 位)
rk3399_64_vr-user:
rk3399_64_discrete_vr-userdebug: //rk3399 平台分体机 VR 产品 userdebug (64 位)
rk3399 64 discrete vr-user:
                               //rk3399 平台分体机 VR 产品 user (64 位)
                               //rk3399 平台平板产品 userdebug (64 位)
rk3399 mid-userdebug:
rk3399 mid-user:
                               //rk3399 平台平板产品 user (64 位)
```

5.1.2 添加一个新的产品

rk3399 平台支持平板、VR、分体机 VR、Box 等产品形态,当需要添加一个新的产品时,可以基于已有的rk3399_mid、rk3399_64_vr、rk3399_64_discrete_vr、rk339_box 来建立,如下以建立一个新的平板产品为例进行说明,具体步骤为:

● 新增文件夹 device/rockchip/rk3399/rk3399_ mid _000,基于 rk3399_mid.mk 创建 rk3399 mid 000.mk,将以及rk3399 目录下的所有文件拷贝至rk3399 mid 000目录下。

```
cd device/rockchip/rk3399
```

```
mkdir rk3399_mid_000
```

cp rk3399_mid.mk ./rk3399_ mid _000.mk

cp rk3399_mid/* rk3399_ mid _000/

● 在 device/rockchip/rk3399/ AndroidProducts.mk 中添加:

```
PRODUCT_MAKEFILES := \
    $(LOCAL_DIR)/rk3399.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3399_64.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3399_64_vr.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3399_64_discrete_vr.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3399_32.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3399_box.mk \
    $(LOCAL_DIR)/rk3399_mid.mk \
```

```
$(LOCAL_DIR)/rk3399_mid_000.mk \
$(LOCAL_DIR)/rk3399_mid_.mk \
$(LOCAL_DIR)/rk3399_64_only.mk
```

● 在 vendorsetup.sh 中添加产品对应的 lunch 选项:

```
add_lunch_combo rk3399-userdebug
add_lunch_combo rk3399_32-userdebug
add_lunch_combo rk3399_box-userdebug
add_lunch_combo rk3399_box-user
add_lunch_combo rk3399_64-userdebug
add_lunch_combo rk3399_64-user
add_lunch_combo rk3399_64_vr-userdebug
add_lunch_combo rk3399_64_vr-user
add_lunch_combo rk3399_64_discrete_vr-user
add_lunch_combo rk3399_64_discrete_vr-user
add_lunch_combo rk3399_mid-userdebug
add_lunch_combo rk3399_mid-user
add_lunch_combo rk3399_mid_000-userdebug
add_lunch_combo rk3399_mid_000-user
```

● 修改 rk3399_ mid _000.mk 及 rk3399_mid_000 目录下的新产品所需要修改的配置。

5.2 常用功能配置说明

5.2.1 常用配置宏说明

宏配置	功能说明
BUILD_WITH_GOOGLE_MARKET	若为 true 则集成 GMS 包,false 不集成
BUILD_WITH_GOOGLE_MARKET_ALL	若为 true 集成 full 的 GMS 包,false 集成 mini
	的 GMS 包
BUILD_WITH_GOOGLE_FRP	使能恢复出场设置保护 FRP 功能
BUILD_WITH_FORCEENCRYPT	使能默认全盘加密
BUILD_WITH_GMS_CER	GMS 认证配置选项
BUILD_WITH_WIDEVINE	集成 Widevine level3 插件库
BOARD_NFC_SUPPORT	使能 NFC 功能
BOARD_SENSOR_ST	选用 ST 的 sensor 框架
BOARD_SENSOR_MPU	选用 MPU 的 sensor 框架
BOARD_SENSOR_MPU_VR	选用 MPU_VR 的 sensor 框架
BOARD_GRAVITY_SENSOR_SUPPORT	使能 G-Sensor
BOARD_COMPASS_SENSOR_SUPPORT	使能 Compass
BOARD_GYROSCOPE_SENSOR_SUPPORT	使能陀螺仪 Gyroscope
BOARD_PROXIMITY_SENSOR_SUPPORT	使能距离感应器
BOARD_LIGHT_SENSOR_SUPPORT	使能光感应器
BOARD_PRESSURE_SENSOR_SUPPORT	使能压力感应器
BOARD_TEMPERATURE_SENSOR_SUPPORT	使能温度传感器

BOARD_ENABLE_3G_DONGLE	使能 3G Dongle 功能
TARGET_ROCKCHIP_PCBATEST	使能 PCBA 测试
BOOT_SHUTDOWN_ANIMATION_RINGING	使能开关机动画+铃声
BOARD_SYSTEMIMAGE_PARTITION_SIZE	System 分区最大容量

5.2.2 预装 APK

Android 上的应用预安装功能,主要是指配置产品时,根据厂商要求,将事先准备好的第三方应用预制进 Android 系统。预安装分为可卸载预安装和不可卸载预安装,本文主要阐述的是**可卸载预安装**的功能。配置步骤如下:

- 新增文件夹 device/rockchip/rk3399/preinstall
- 拷贝需要预制的第三方应用到上述文件夹,注意 apk 文件名尽量使用英文,避免空格。

编译结束后会在 out/target/product/rk3399_mid/system/目录,生成 preinstall 文件夹,文件夹内包含了预制的第三方应用。烧录后,系统会自动安装这些应用到 data/app 目录。因此他们是可卸载的。需要注意的是,在 preinstall 目录中的应用,即使用户在使用过程中将其卸载,但在恢复出厂设置后,应用又会自动安装。如果希望恢复出厂设置后不再恢复预安装应用,可以将上述文件夹名字改为 preinstall_del 即可实现。

5.2.3 开/关机动画及铃声

需要在产品的 makefile 中配置 BOOT_SHUTDOWN_ANIMATION_RINGING: = true,并且准备如下相应资源文件,编译结束后对应的资源文件会拷贝到相应的 out 目录下。

将开机铃声 复制到 device/rockchip/common/startup.wav (源码路径)

将关机铃声 复制到 device/rockchip/common/startup.wav (源码路径)

将开机动画 复制到 device/rockchip/common/bootanimation.zip (源码路径)

将关机动画 复制到 device/rockchip/common/shutdownanimation.zip (源码路径)

5.3 Parameter 说明

rk3399 平台有平板、VR、分体机、Box 等产品形态,不同的产品形态可能需要不同的 parameter 参数,请参考 device/rockchip/rk3399/下子目录 rk3399_mid、rk3399_box、rk3399_64_vr 中的来相应修改配置,关于 parameter 中各个参数、分区情况细节,请参考\RKDocs\RKTools manuals\ Rockchip Parameter File Format Ver1.3.pdf。

5.4 新增分区配置

请参考\RKDocs\RKTools manuals\Android 增加一个分区配置指南 V1.00.pdf

5.5 OTA 升级

请参考\RKDocs\RKTools manuals\ RK SDK OTA 包生成方法.pdf

6 常用工具说明

- 6.1 StressTest
- 6.2 DeviceTest
- 6.3 PCBA 测试工具
- 6.4 DDR 测试工具
- 6.5 update.img 打包
- 6.6 固件签名
- 6.7 序列号/Mac/厂商信息烧写
- 6.8 量产工具使用